

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

關連交易
關於進一步延長貸款融資的2022年補充協議
及提供財務資助

2022年補充協議

於2022年4月28日，本公司的全資附屬公司芯智雲國際、本公司的全資附屬公司芯智國際與銘冠訂立2021年貸款融資協議的2022年補充協議，據此(其中包括)，訂約方已同意(i)融資(即總金額為3,500,000美元的美元循環貸款融資)的到期日進一步延長至2023年4月30日，年利率為8%，期限為2022年5月1日至2023年4月30日(包括首尾兩日)；及(ii)芯智國際將獲解除，而芯智雲國際將承擔作為2021年貸款融資協議貸款人的所有權利及義務。除上述者外，2021年貸款融資協議之所有其他條款將維持十足效力及作用。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生於過去12個月為前任董事，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定共同持有的實體。

根據上市規則第14A.26條，2022年補充協議所載芯智雲國際向銘冠提供的融資構成本公司的關連交易。由於有關融資的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，故融資須遵守上市規則第14A.76(2)條項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

由於誠如上文所披露，燕先生為本公司的關連人士，而李先生為銘冠的主要股東，故根據上市規則，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)各自以財務資助形式構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並無以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為2020年5月8日及2021年4月28日的公告，內容有關芯智國際與銘冠所訂立2020年貸款融資協議及2021年貸款融資協議(作為2020年貸款融資協議的補充協議)。

根據2020年貸款融資協議的條款，芯智國際同意向銘冠提供總額為3,800,000美元的美元循環貸款融資，年利率為7%，到期日為2021年4月30日。

於2021年4月28日，芯智國際與銘冠訂立2021年貸款融資協議，據此，2020年貸款融資協議的若干條款已獲補充，包括但不限於經修訂融資(即為數合共3,500,000美元的美元循環貸款融資)的到期日延後至2022年4月30日，年利率為8%，期限為2021年5月1日至2022年4月30日(包括首尾兩日)。

2022年補充協議

於2022年4月28日，芯智雲國際、芯智國際與銘冠訂立2021年貸款融資協議的2022年補充協議，據此(其中包括)，訂約方已同意(i)融資(即總金額為3,500,000美元的美元循環貸款融資)的到期日進一步延長至2023年4月30日，年利率為8%，期限為2022年5月1日至2023年4月30日(包括首尾兩日)；及(ii)芯智國際將獲解除，而芯智雲國際將承擔作為2021年貸款融資協議貸款人的所有權利及義務。除上述者外，2021年貸款融資協議之所有其他條款將維持十足效力及作用。2022年補充協議的主要條款載列如下：

日期： 2022年4月28日

訂約方： (1) 芯智雲國際，本公司的全資附屬公司(作為貸款人)；
(2) 芯智國際，本公司的全資附屬公司(作為前貸款人)；
(3) 銘冠(作為借方)。

融資： 美元循環貸款融資總額仍為3,500,000美元

可用期間： 芯智雲國際同意將銘冠可獲得的貸款融資由2022年4月29日延長至2023年4月29日

到期日： 芯智雲國際同意將到期日由2022年4月30日延長至2023年4月30日

利率： 與2021年貸款融資協議相同，即每年8%

個人擔保

為擔保擔保責任，燕先生及李先生各自於2022年4月28日分別訂立個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)，據此，燕先生及李先生各自不可撤回及無條件地(其中包括)向芯智雲國際擔保各義務人準時履行所有擔保責任，並承諾當其他義務人於到期時並無支付任何擔保責任金額時，其將即時應要求支付該金額，猶如其為主要義務人。

先決條件

於下列先決條件獲達成後，2022年補充協議將自生效日期起生效：

1. 芯智雲國際收到銘冠的董事會會議記錄副本或簽署2022年補充協議及與2022年補充協議有關的所有附屬文件的類似授權；
2. 2022年補充協議由芯智雲國際、芯智國際及銘冠各自正式簽立；
3. 個人擔保(李紅勝)由各訂約方正式簽立；
4. 有關個人擔保(李紅勝)之警告通知已由各訂約方正式簽立；
5. 個人擔保(燕青)由各訂約方正式簽立；
6. 有關個人擔保(燕青)之警告通知已由各訂約方正式簽立；及
7. 接收芯智雲國際可能合理要求的其他文件及資料。

轉讓

自生效日期起，根據2022年補充協議的條款，訂約方同意：

1. 芯智雲國際無條件、不可撤回及絕對地承擔芯智國際有關2021年貸款融資協議的所有權利及義務；及
2. 芯智國際不再就2021年貸款融資協議擁有權利及義務。

訂立補充協議的理由及裨益

銘冠正擴大其作為電子元器件分銷商的業務營運。為確保該穩定增長將得到足夠財力支持，銘冠將需要額外現金流量撥付因其客戶下達訂單所產生的商品採購訂單。據估計，銘冠對該等額外現金流量的需求將維持較先前預期更長的時間。因此，經銘冠與本公司公平磋商後，本公司同意透過芯智雲國際訂立2022年補充協議。

董事(包括獨立非執行董事)認為，儘管2022年補充協議並非於本集團日常及一般業務過程中訂立，但2022年補充協議的條款乃由本公司與銘冠按公平原則磋商後訂立，乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無董事於2022年補充協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，且概無董事須就批准2022年補充協議之相關董事會決議案放棄投票。

有關銘冠的資料

銘冠為一間根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。銘冠連同其全資附屬公司為領先的電子元器件分銷商。銘冠的大部分客戶位於亞洲，惟銘冠亦向跨國公司客戶提供服務及產品。銘冠的一核心業務為逆向供應鏈管理服務，在市場供應短缺的情況下為客戶提供解決方案。銘冠亦擅於通過高效、對市場敏銳的方式處理客戶的多餘存貨以協助彼等在全球範圍內經營OEM/EMS業務。銘冠由Smart IC Cloud、燕先生、李先生、Ng Teck Yee (Jason)先生及倪莉女士分別擁有25%、22.5%、22.5%、22.5%及7.5%，由於銘冠的財務業績根據相關會計政策併入本集團的綜合財務報表，故其為本公司的附屬公司。詳情請參閱本公司日期為2018年10月22日的公告。

有關本集團的資料

本集團是一家中國本土領先的集成電路及其他電子元器件全能型分銷商及技術增值服務商，我們的業務類型涵蓋授權分銷、獨立分銷、電商平台、技術增值及光通信芯片的設計與製造。本集團的服務網點覆蓋中國大陸及亞太多個區域，可以為亞太地區的電子行業客戶提供半導體芯片及各類電子元器件供應鏈服務，並提供技術解決方案及配套的技術支援。芯智雲國際及芯智國際的核心業務均為電子元器件貿易，並各自為本公司主要附屬公司之一。

上市規則涵義

於本公告日期，本公司的全資附屬公司Smart IC Cloud持有銘冠25%已發行股本。燕先生於過去12個月為前任董事，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。彼亦為銘冠的主要股東。因此，銘冠被視為上市規則第14A.27條所界定共同持有的實體。

根據上市規則第14A.26條，2022年補充協議所載芯智雲國際向銘冠提供的融資構成本公司的關連交易。由於有關融資的最高適用百分比率(定義見上市規則)不超過5%，故融資須遵守上市規則第14A.76(2)條項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

由於誠如上文所披露，燕先生為本公司的關連人士，而李先生為銘冠的主要股東，故根據上市規則，個人擔保(燕青)及個人擔保(李紅勝)各自以財務資助形式構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.90條，由於董事認為有關財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並無以本集團資產作抵押，故本集團收取的有關財務資助獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年貸款融資協議」	指	芯智國際與銘冠訂立日期為2020年5月8日的3,800,000美元循環貸款融資協議。有關詳情請參閱本公司日期為2020年5月8日的公告
「2021年貸款融資協議」	指	芯智國際與銘冠訂立日期為2021年4月28日的3,500,000美元循環貸款融資協議(補充2020年貸款融資協議)。有關詳情請參閱本公司日期為2021年4月28日的公告
「2022年補充協議」	指	芯智雲國際、芯智國際與銘冠於2022年4月28日訂立有關2021年貸款融資協議的補充協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	芯智控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	2022年補充協議所載先決條件獲達成並獲芯智雲國際信納的日期

「融資」	指	根據2022年補充協議所協定總額為3,500,000美元的美元循環貸款融資
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保責任」	指	根據或就任何財務文件(包括2022年補充協議、個人擔保(燕青)、個人擔保(李紅勝及芯智雲國際及銘冠指定的任何其他文件))及在各情況下,不論單獨或共同或與任何其他人士共同或個別,不論實際或或然及不論作為委託人、擔保人或其他身份,義務人應付、結欠芯智國際或產生的所有現時及未來款項、債務、責任及負債
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「李先生」	指	李紅勝,中華人民共和國公民,為銘冠的主要股東
「燕先生」	指	燕青,新加坡共和國公民,為前執行董事
「義務人」	指	銘冠、燕先生及李先生的統稱,各自為「義務人」
「訂約方」	指	芯智雲國際、芯智國際及銘冠的統稱
「個人擔保(李紅勝)」	指	李先生(作為擔保人)為芯智雲國際提供的個人擔保
「個人擔保(燕青)」	指	楊先生(作為擔保人)為芯智雲國際提供的個人擔保
「銘冠」	指	銘冠國際香港有限公司,一間根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司,於本公告日期由本公司間接持有25%
「Smart IC Cloud」	指	Smart IC Cloud Holdings Limited,一家根據英屬處女群島法律正式成立及有效存續的公司,為本公司的全資附屬公司

「芯智雲國際」	指	芯智雲國際有限公司，一家根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「芯智國際」	指	芯智國際有限公司，一家根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
芯智控股有限公司
 董事長及執行董事
田衛東

香港，2022年4月28日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生及麥漢佳先生，本公司獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及許微女士。